



HPC Solution

for Research & Development

CAE
Simulation
Materials Informatics
Bioinformatics
LLM
Generative AI
Deep Learning



CAE・シミュレーション・AI 開発向け

ワークステーション/HPC/AI サーバー

導入実績・製品ラインナップカタログ

柔軟なカスタマイズ

国内自社工場生産

高品質・短納期

アプライドは HPC で豊かな研究と開発環境をご提供します。

アプライドではISO認定の国内自社工場にて企画開発・製造・保守までを一貫して行っています。お客様ごとのニーズに合わせたワークステーション/HPC/AIサーバーを1台からフルカスタマイズ・短納期でご提供いたします。

お電話でのお問い合わせはこちら

TEL 092-481-8050

受付時間 平日 10:00~17:00

<https://bto.applied.ne.jp/>

または

アプライドHPC



CONTENTS

02	CONTENTS掲載/ アプライドHPC製品の生産品質へのこだわり	09	MSI×APPLIED HPC・AIサーバーモデル紹介
03	NVIDIA DGX Station 搭載 次世代AIワークステーション	10	科学技術計算向け HPC紹介
04	各種用途向けHPC・AIサーバー導入事例	11	GPU Server/科学技術計算向け HPC (AMD) 紹介
05		12	HPC Deep/HPC AI Server/Edge Server紹介
06	ディープラーニング計算機/GPU比較	13	ラックマウント型 エントリーサーバー・ストレージサーバー紹介
07	4UハイエンドGPUサーバー/GPU比較	14	ラックマウント型 AIサーバー・ストレージサーバー紹介
08	MSI×APPLIED HPC・AIサーバーモデル紹介	15	テクニカルメニュー (ソフトウェア別)
		16	アプライドHPC&AI専用サイト

福岡にHPC開発部門生産工場を設置



MSA-QS-5054
MSA-ES-1999

MS
CM024

ISO9001
ISO14001認定工場

認定組織:生産工場(技術・生産課、HPC&BTO推進課)
認定範囲:パソコン及び関連IT機器の製造

ISO 9001は企業がお客様に提供する製品・サービスの品質を常に向上させていくことを目指すマネジメントシステムで、ISO14001は環境マネジメントシステムに関する国際規格であります。当初より、大学及び研究機関・企業様の研究内容の多様化、スピード化に合わせ、独自のセル生産によるオーダーメイド製造を行ってまいりましたが、今回の認証取得を機に、当社は、お客様にご提供する製品・サービスの品質を継続的に高めつつ、持続可能な環境状態に対応していくよう今後も努力を続けてまいります。

アプライドHPC製品の生産品質へのこだわり

アプライドは1994年より自社工場にてBTOを製造しています。お客様が安心して長くご利用できるよう、耐久性、信頼性、スペックが、社内品質に合格したものだけを採用し、製品性能をフルに発揮できるように日々の検証を行っています。また、部材供給メーカーや国内正規代理店とも定期的な品質ミーティングを行い、安定した製品のご提供はもちろんのこと、継続的な品質向上に努めています。



国内自社工場生産へのこだわり

ご注文いただいたBTO・HPC製品は、国内の自社工場でのみ製造しています。お客様のさまざまなご希望・ご要望を実現しながら誕生するPCだからこそ、品質にもこだわり続けます。製造基準・マニュアルによる品質の安定化と、経験豊かな製造スタッフによるきめ細かな生産工程で、1台1台丁寧に組み立てます。



自社品質基準による部材品質へのこだわり

オリジナルBTO・HPC製品に使用する部材は、自社品質基準をクリアしたものだけを採用しています。高い性能と耐久性を求められるHPC製品はもちろんのこと、一般的な事務などでご利用されるBTOについても、安心してご利用いただけるように、部材採用選定から製造まで、一貫して品質向上に努めています。



初期不良を未然に防ぐエージング検査

アプライドの国内自社工場で生産されるBTO・HPC製品は、標準で12時間のエージング検査を行っています。ある一定の負荷をかけた状態で、長時間の安定した動作を最終確認しています。お客様の目に見えないサービスですが、このテストにより初期不良を未然に防ぐことができます。さらに、ご希望のお客様には、無料で72時間のエージング検査も実施しております。HPC製品や基幹システムでご利用になるPCなど、より安定した動作確認が必要なお客様にも安心してご利用いただけます。



製造現場のこだわり動画

製造現場のこだわりを動画でご覧いただけます。



オンサイトハードウェア保守サービス

オンサイトハードウェア保守サービスは、弊社にてご購入いただいたワークステーション製品の保守作業を現地で行うサービスです。エンジニアがお客様のところへ行って作業を行いますので弊社に製品をお送りいただくことなくハードウェアの修理作業をお受けいただけます。

オンサイトハードウェア保守サービスの流れ

1. お客様 → アプライド サポート受付
メールもしくは電話による障害受付
2. アプライド サポート受付 → お客様
ヒアリング&ログによる障害解析・原因特定
3. アプライド 技術者 → お客様
交換用パーツを持ってお客様の元へ

保守サービス料金などの詳細は
下記WEBサイトへ
https://bto.applied.ne.jp/onsite_service.html



注目の「新商品登場！」

" 次世代 AI ワークステーション "

NVIDIA DGX Station は、AI 専用設計された次世代ワークステーションです。

XpertStation WS300 on NVIDIA DGX Station™ Architecture

NVIDIA GB300 Grace Blackwell Ultra Desktop Superchip と 748GB の大容量コヒーレントメモリを搭載した MSI の XpertStation WS300 は、NVIDIA DGX Station™ アーキテクチャを採用しており、デスクサイドから直接、AI トレーニング、推論、シミュレーションといったワークロードに対してデータセンタークラスのパフォーマンスを提供します。



XpertStation WS300 の特長とは？



計算密度の高いアーキテクチャ

NVIDIA GB300 Grace Blackwell Ultra デスクトップスーパーチップは、高性能な NVIDIA Grace CPU と NVIDIA Blackwell Ultra GPU を NVIDIA® NVLink® チップ間相互接続 (C2C) を介して組み合わせることで、卓越した演算密度と効率的なシステム通信を実現します。



高速ネットワーク

NVIDIA ConnectX®-8 SuperNIC™ は、最大 400Gb/s の低遅延・高帯域幅の接続性を提供し、大規模な AI ワークロード向けに高速データ転送と拡張可能なパフォーマンスを実現します。



大容量コヒーレントメモリ

748GB のコヒーレントメモリープールは、252GB の HBM3e GPU メモリと 496GB の LPDDR5X システムメモリを C2C インターコネクトで組み合わせることで、より高速なデータアクセスと効率的な大規模 AI モデルトレーニングを実現します。



エンドツーエンドの AI ソフトウェアサポート

NVIDIA AI ソフトウェアスタックは、ファインチューニング・推論・データサイエンスなどの AI ワークロード向けにフルスタックソリューションを提供し、デスクトップからデータセンターまでシームレスな開発と展開を可能にします。

XpertStation WS300



サイズ

247.8mm(9.76")Wx527.9mm(20.78")Hx582.7mm(22.9")D



GPU

Single NVIDIA Blackwell Ultra GPU



内部ストレージ

(2) 2280 PCIe 5.0 x4 NVMe M.2 ports
(2) 2280 PCIe 6.0 x4 NVMe M.2 ports



ネットワーク

(2) QSFP112 ports with NVIDIA ConnectX-8 SuperNICs
(1) 10GBase-T Ethernet port with Marvell AQC113



CPU

Single NVIDIA Grace™ CPU Superchip with 72 Arm® Neoverse V2 cores



メモリ

748 GB of Coherent Memory
- CPU Memory 496GB LPDDR5X ; 396 GB/s
- GPU Memory 252GB HBM3e ; 7.1 TB/s



拡張スロット

(1) PCIe 5.0 x16 FHFL double wide slot
(2) PCIe 5.0 x16 FHFL single wide slots with x8 signals
(1) PCIe 2.0 x1 2230 M.2 for WiFi/BT



電源

(1) 1600W ATX 80 PLUS Titanium
Dimension (WxHxL): 150 x 86 x 210 mm
Rating:
AC Input: 100-114Vac, 15A, 47-63Hz
Output: Max 1300W
AC Input: 115-240Vac, 15-8A, 47-63Hz
Output: Max 1600W
*C19 power cords are required and will be offered as optional accessories.



セキュリティ

Chassis Intrusion
On-board TPM2.0
Hardware Root of Trust - Microchip CEC1736 supported



サーバー管理

(1) 1000Base-T Dedicated Server Management Port
ASPEED AST2600 with AMI MegaRAC based firmware supporting IPMI 2.0 and DMTF Redfish API
eMMC for local BMC storage media

価格は別途お問い合わせください

HPC・AI導入事例

HPC製品・AIサーバーを活用した事例をご紹介します。



九州大学 教授 廣瀬 慧氏

2007年九州大学 理学部数学科卒業、2008年同大学院 数理学府数理学専攻 修士課程を早期修了、2011年には博士後期課程を修了し、2011年から5年間にわたり大阪大学大学院 基礎工学研究科数理教室で助教を勤める。2016年から九州大学 マス・フォア・インダストリ研究所 准教授、2022年からは同研究所の教授となる。

先生の研究分野の1つである「因子分析」について教えてください

統計学において重要なのは、データを解析し結果を導くための「手法」です。私は因子分析やグラフィカルモデルなど、多変量解析における新たなスパース推定法の研究に取り組んでいます。因子分析は、データの背後にある共通要素（因子）を見つけ出す手法で、再生可能エネルギーや電力などの社会課題を数理的に捉えることが可能です。学生時代から関心を持って取り組んできたテーマであり、社会問題に応用する独自の解析手法として研究を進めています。一方で、因子分析を一般化するとパラメーター数が大幅に増え、計算量が膨大になります。実験やシミュレーションを効率的に進めるためには、高速な計算環境が欠かせません。アプライドのサーバーを導入したことで、並列演算による処理速度が向上し、研究全体のスピードアップにつながっています。



先生が数学の研究者になったきっかけを教えてください

数学の証明問題で論理を組み立てていく過程が好きだったことから、大学では数学科に進みました。大学で応用数学に出会い、数学という得意分野を通じて社会に貢献できる可能性を感じたことが、研究者を志す原点です。AIなどの先端技術を支える数学の力を活かし、今も汎用性の高い手法づくりに取り組んでいます。



因子分析による抽出法を一般化することで、世の中にどんな影響を与えるのでしょうか？

因子分析による抽出法を一般化することで、さまざまな分野への応用が可能になります。例えば、MRI装置を用いて脳の活動を解析する「fMRI」では、脳内ネットワークの解析に因子分析が欠かせません。因子分析を一般化することで、画像データの特徴をよりの確に捉えられるようになることが分かってきました。



先生の研究の先にある展望について教えてください

私が目指しているのは、世界中の人々の暮らしを豊かにするソフトウェアの開発です。シミュレーションと数学的な証明を組み合わせる手法を一般化し、その成果をソフトとして提供することで、電力需給の予測など、各分野の技術者の仕事を支えたいと考えています。こうした技術は、新素材の開発にも応用できます。AIを活用して従来にはない特性を持つ材料を生み出すことで、ものづくりの可能性を広げ、将来的には低コスト化にもつながると期待しています。開発した因子分析ソフトはWeb上で公開し、誰でも利用できる形で提供しています。多くの人に使われ、役立っていると実感できることが研究の原動力です。今後も、世界中の技術者に活用され、人々の暮らしを支える汎用性の高いソフトウェア開発を通じて社会に貢献していきたいと考えています。

アプライド製品に対する印象を教えてください

3年前から継続してアプライドのサーバーを利用しています。以前から社名は知っており、最初は気軽な問い合わせがきっかけでしたが、些細なトラブルでも電話一本ですぐに対応してくれる誠実な姿勢に触れる中で、自然と信頼が深まりました。今では何かあっても「アプライドに聞けば大丈夫」と思えるほど、安心して任せられる存在です。





東京大学 教授 酒井 幹夫 氏

2006年東京大学大学院工学系研究科システム量子工学専攻博士課程修了、博士(工学)。翌年から同研究科にて助教、2008年に同研究科准教授に就任。2023年3月から原子力国際専攻 教授に就任。現在、世界大学ランキングトップ10のImperial College London、University of Surreyの英国2大学の客員教授(名誉職)にも就任している他、Chemical Engineering Science誌(Elsevier)およびGranular Matter誌(Springer)の編集委員にもアジアを代表する数値シミュレーションの権威として選出され、国際的に粉体シミュレーション分野を牽引している。

最先端粉体シミュレーション」に取り組むようになったきっかけを教えてください

原子力では、高放射線・高圧・高温の過酷環境が研究対象となるため、実際に実験することが極めて困難です。そのため原子力の分野では、黎明期からコンピュータでのシミュレーション技術に注目が集まっていました。原子力では他の分野より高い安全性が求められるため、シミュレーションには実現象の高い再現性と高効率性が求められます。また、私は原子力国際専攻において粉体を研究していますが、原子燃料は粉体プロセスを経て製造されるため原子力と粉体というのは決してかけ離れたものではありません。

実際、私たちの身近なところには、粉で構成されたものが数多く存在しています。粉体とは、微小な固体粒子が集積した物質のことなのですが、例えば、医薬品、食品、触媒、鉱物など、さまざまな工業製品の75%くらいが粉の形状を経て作られています。コピー機のトナーも粉で作られており、電池や鉄鋼なども粉体工学がカバーします。牛乳も1ミクロンの単位で粒子(コロイド)と液体が混ざっているように、私たちの身近なところに粉体はあふれています。このように、最先端粉体シミュレーションは、幅広い工学の研究トピックに応用できるツールとも言えます。



では、「最先端粉体シミュレーション」について教えてください

私の取り組んでいる最先端の粉体シミュレーション技術では、離散要素法(DEM)と呼ばれる計算手法が広く使われています。粒子同士の相互作用を考慮しながら力学的な計算を行うことで、粉体が係わる物理現象を予測できます。

DEMでは、スプリング、ダッシュポットおよびフリクションスライダーを使って個々の粒子同士の相互作用を計算し、この計算を繰り返すことにより粒子の振る舞いを模擬します。DEM自体は1979年に提案された(古いと思われる?)計算モデルですが、現在では粉体および混相流のシミュレーションにおいて世界標準となっています。

粉体シミュレーションを実行する際の計算手法には、上記のDEMのほかに、分子動力学法、モンテカルロ法、格子ボルツマン法などがあります。私のグループでは、DEMにいくつかの手法を組み合わせることで、粉体プロセスのデジタルトランスフォーメーション(DX)の実現化に取り組んでいます。

最近、欧米ではIndustry 4.0(日本ではSociety 5.0)が大きな注目を浴びていますが、実際に今、製造業では第4次産業革命が進行中です。第4次産業革命では、サイバーフィジカルシステムを採用したスマートファクトリー概念が具現化を目指します。サイバーフィジカルシステムでは、現実空間がサイバー空間に模擬され、両者が同期され、製造工程が効果的に制御されます。サイバーフィジカルシステムのことをデジタルツインとも呼んでいます。

実際の粉体プロセスのサイバーフィジカルシステムを導入して、リアルタイム制御をしようとすると、スパコンが必要になるかと思います。標準的な粉体プロセスでは、10億個超の粒子が扱われるのですが、世界屈指の性能のスパコンを使用しても、粉体プロセスをリアルタイムでシミュレーションをするのはかなり難しいのが現実です。

高速に粉体が係わる現象を模擬するという観点から、私たちが研究していることは、粉体プロセスを対象とした縮約モデルの開発です。縮約モデルは、ROM(Reduced Order Model)※1と呼ばれるのですが、このモデルでは通常のシミュレーションのように方程式をきちんと解くのではなく、データから自由度を減らして計算します。その際、POD(Proper Orthogonal Decomposition)や機械学習をはじめとするデータサイエンスの技術を使用します。このようにして縮約モデルを開発し、シミュレーション結果を教師データ※2として活用して、計算結果を予測することを行います。

産業界ではシミュレーション結果が日々蓄積されていることから、縮約モデルを使えば様々な条件を新たに計算することなく予測することが可能だと思えます。縮約モデルによる計算結果の予測には解決すべき研究課題があるため研究を続けています。

※注釈1…ROM(Reduced Order Model)は、3Dモデルの本質的な挙動を維持したままモデルの次元を落とし(縮退化)、解析時間とデータの容量を大幅に削減する手法です。

※注釈2…教師データとは、機械学習の学習データのうち、問題と正解をセットにしたデータのことで、



今後の展望について教えてください。

私たちがこれまでに開発してきた計算モデルを用いれば、固体粒子(非球形粒子を含む)、固気・固液二相流および固気液三相流を対象とした複雑現象を模擬することができます。また、これらの計算モデルは常に妥当性確認を行っているため、実現象の再現性のよい結果を得ることができます。そのため、万一、計算結果が実現象と異なる場合、何が原因なのかを容易に同定することができます。

ですから、先に述べたスカラフィールドベースの壁境界モデルや陰解法などの複数の計算モデルを組み合わせることでシミュレーションを実行することで、実現象の再現性がよく高効率に計算結果が得られると思います。これらの手法を組み合わせた最先端粉体シミュレーションを用いることで粉体産業のDXを推し進め、幅広い産業で我々の技術を有効活用いただければと思います。

また、私の研究室は、学生が国内外の学会で表彰されるだけでなく、学科(コース)・専攻で年間ただ一人に贈られる工学部長賞・工学系研究科長賞を極めて多くの学生が受賞しています。今後も、粉体工学の未来を担うことのできる学生や若手研究者の育成に積極的に貢献していきたいと考えています。

アプライド オリジナル

CERVO HPC シリーズ

WS-SR630 model

高性能 ワークステーション専用筐体
タワー型&ラック型対応!

タワー型設置対応



GPU固定用PCIホルダーを標準装備
簡易水冷ユニットを搭載可能

2.5/3.5 インチ対応
ベイを8基搭載



GPU強制冷却ファン搭載

ラッキング対応
(オプション)



レールキット(オプションキット販売)



製品仕様

製品タイトル	ディープラーニング計算機 [1GPU] NVIDIA Blackwell GPU 搭載
シリーズ名・型番	CERVO Grasta Type-ALIS35WC-BW×1
特徴	4Uラックマウント!最大2GPU
OS	Ubuntu 24.04 インストール代行
CPU	インテル Xeon w5-3535X プロセッサー - 2.9GHz to 4.6GHz; TB4.8GHz (Single Core) - 20コア; 40スレッド
メモリー	256GB (32GB x8) - DDR5-5600; Registered-ECC
ストレージ(標準)	960GB M.2 NVMe-SSD 高耐久仕様
光学ドライブ	非搭載
グラフィック	[1基] NVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition - 96GB; GDDR7

- インテル W790 チップ・セット
- 簡易水冷プロセッサー・クーラー
- [1ポート] 10ギガビット、[1ポート] ギガビット (IPMI2.0兼用)
- 電源 1,200W/100V; 1,500W/200V - 80 Plus Platinum 認証
- 保証 3年間センドバック方式ハードウェア保証



製品タイトル	ディープラーニング計算機 [2GPU] NVIDIA Blackwell GPU 搭載
シリーズ名・型番	CERVO Deep Type-ALES5S-BW×2
特徴	4Uラックマウント!最大2GPU
OS	Ubuntu 24.04 インストール代行
CPU	[2基] インテル Xeon Gold 6548Y+ - 2.5GHz to 3.2GHz; TB 4.1GHz (Single Core) - 32コア; 64スレッド
メモリー	512GB (32GB x16) - DDR5-5600; Registered-ECC
ストレージ(標準)	960GB SATA3-SSD 高耐久仕様
光学ドライブ	非搭載
グラフィック	[2基] NVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition - 96GB; GDDR7

- インテル C741 チップ・セット ■アクティブ・プロセッサー・ヒートシンク
- [2ポート] 10ギガビット
- 電源 1,200W/100V; 1,500W/200V - 80 Plus Platinum 認証
- 保証 3年間センドバック方式ハードウェア保証



GPU比較表

製品名	RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition	RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition	RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition	NVIDIA RTX PRO 5000 Blackwell (48GB)	NVIDIA RTX PRO 5000 Blackwell (72GB)
製品画像					
アーキテクチャ	Blackwell	Blackwell	Blackwell	Blackwell	Blackwell
メモリー容量規格	96GB GDDR7 ECC	96GB GDDR7 ECC	96GB GDDR7 ECC	48GB GDDR7 ECC	72GB GDDR7 ECC
CUDAコア数	24,064	24,064	24,064	14,080	14,080
Tensorコア数	752	752	752	440	440
RTコア数	188	188	188	110	110
メモリー帯域幅(GB/s)	1,792GB/s	1,792GB/s	1,597GB/s	1,344 GB/s	1,344GB/s
消費電力	600W	600W	300W	300W	300W

[8GPU] NVIDIA H200 NVL 搭載

4U ハイエンド GPU サーバー

AISV-X6760Px2MS3Q4TU4E1H200X8



ハイエンドGPU
NVIDIA H200 NVLを
最大8基 搭載可能



NVIDIA H200 NVL コア GPUは、市場を一変させるパフォーマンスとメモリ機能で生成 AIとHPC ワークロードを強化します。HBM3e を搭載した初のGPUであるH200の大容量かつ高速のメモリは、HPC ワークロードのための科学コンピューティングを推進しながら、生成AIと大規模言語モデル(LLM)の高速化を促進します。

製品仕様

シリーズ名・型番	AISV-X6760Px2MS3Q4TU4E1H200X8
フレームワーク	NVIDIA GPU Cloud (TensorFlow/Pytorch) インストール
OS	Ubuntu22.04LTS&CUDA12 インストール
CPU	[2CPU]Xeon6 6760P 64C/128T 2.2 GHz (最大3.8GHz) 320MB DDR5(6400MHz) TDP=330 W
メモリー	1536GB(64GB×24)DDR5-5600 1.2V 2RANK Registered ECC DIMM
SSD OS起動用	3.84TB E1.S NVMe SSD エンタープライズSSD
内蔵グラフィック	ASPEED AST2600 BMC 64GB (VGAX1)IPMI
GPUカード	[8GPU]NVIDIA H200 Tensor Core GPU 141GB NVL HBM3e ECC (映像出力無し)PCI-E5.0x16

- シャーシー 4U 2S Intel Xeon6 Processors AI Server D800xH175xW438.5mm
- 冷却FAN [標準] システム内部冷却用FAN 合計10基 8080 Hot-swap System fans
- CPUクーラー Air cooling modules for max. 350W CPU(x2)
- チップセット System On Chip 最大8TB (16)+(16) DIMM slots CPUDTP:Max up to 350W
- LANカード Intel X710-AT2 Dual 10Gigabit LAN controller
- IPMIマネジメントポート IPMI Realtek RTL8211E
- 電源 3000W 80 PLUS Platinum認証 冗長化電源 (3+1)1200 Watts (100V AC input) 3000W (200V AC input) 3200W (240V AC input)
- 外形寸法 約438.5mm (W)x175mm (H)x800(D) mm 突起部は除く
- 保証 [標準] 3年間センドバック方式ハードウェア保証



GPU比較表

製品名	NVIDIA H200 NVL	NVIDIA H100 NVL	NVIDIA A800	NVIDIA L40S	NVIDIA L4
製品画像					
CUDA コア数	14,592	14,592	6,912	18,176	7,424
Tensor コア数	456	456	432	568	232
メモリー容量 規格	141GB HBM3e	94GB HBM3	40GB HBM2	48GB GDDR6	24GB GDDR6X
メモリー帯域幅 (GB/s)	4,800GB/s	3,917GB/s	1,555GB/s	864GB/s	300GB/s
クロック数	1,365~1,785MHz	1,665~1,837MHz	765~1,410 MHz	1,065~2,520 MHz	795~2,040MHz
FP64 (TFLOPS)	34	34	9.7	1.4	0.473
FP32 (TFLOPS)	67	67	19.5	92	30.3
FP16 Tensor (TFLOPS)	1,979	1,979	624	733	242
消費電力	600W	400W	240W	350W	72W



HPC製品・AIサーバーで豊かな研究と開発環境を

世界有数の総合コンピューターメーカーMSI社と国内オリジナルコンピューターの製造・販売を手掛けるアプライドとのコラボレーション。
HPC・サーバー、最先端のコンピューターソリューションをご提供いたします。

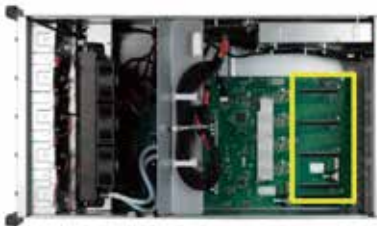
- AI学習開発
シミュレーション向けサーバー
- CPU演算向けサーバー
- シミュレーション/データ解析/
ディープラーニング用途HPC



唯一無二の拡張性

3.5スロットのGPUを最大4枚 搭載しても余裕のある空間

これまでのGPUサーバーであれば、大型のグラフィックボードを複数搭載するとケースの大きさに対して限界のスペースとなってしまう、電源コネクタの配置や冷却に余裕がない製品が大半でした。そこで、こちらのケースであれば非常にゆとりのある空間を確保することができるため、ハイエンドクラスのスペックを100%引き出す構成が可能になります。



NVIDIA GeForce シリーズ



GeForce RTX5090
GeForce RTX5080

3.5スロット占有GPUが
最大4基搭載可能!

様々な用途に適用

AMD EPYC 64コア128スレッド 4Uラックマウントサーバー

最大4基のGPUを増設
高い拡張性と安定稼働
長時間運用対応



- OS: ubuntu 22.04 LTS インストール代行
- CPU: AMD EPYC 9554 64コア/ 128スレッド
-3.1GHz(最大3.75GHz) TDP=360
- メモリ: 128GB (32GB×4) DDR5-5600
-1.2V 2RANK Registered ECC DIMM
- SSD: 960GB U.3 NVMe MTBF=200万時間
-Read ~6800MB, Write ~1400MB/Sec
-エンタープライズ向け高耐久SSD採用
- グラフィックス: [オンボード]
-ASPEED AST2600 BMC 64MB(VGA x1)
- 電源: 3000W 80PLUS PLATINUM認証
-冗長化電源(1+1)1200W (100V AC入力時)2800
- シャーシ: 4U 4th Gen AMD EPYC 1S AI Server
-D831xW438xH176mm
- CPUクーラー: 液冷 4U Liquid cooling module
-for max. 500W CPU (x1)
- マザーボード: System On Chip 最大3TB
-12-channel DIMM slot,
CPU TDP: Maxup to 400W
- 有線ネットワーク: Intel X550-AT2
-10 Gigabit/2ポート/PCI-Ex4
- TPMチップ: TPM 2.0セキュリティモジュール

上記スペックからカスタマイズも承ります。メモリ・ストレージの増設やグラフィックボードの増設、OS変更から各種部品のメーカー変更など様々な要望にお応えできます。詳しい料金や構成のご相談はお客様もしくはWebサイトにてご確認ください。

HPC AI Server AISV-X6527Px2MS3Q4TE1S

NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell
Server Edition 8基搭載
Xeon6 Processors AI Server



OS	Ubuntu 24.04 LTS インストール代行
外形寸法	約438.5mm (W) × 175mm (H) × 800 (D)mm 突起部は除く
プロセッサー	[2CPU] Xeon6 6527P 24C/48T 3.0GHz(最大4.2 GHz) 144MB DDR5(6400MHz) TDP=225 W
プロセッサー・ファン	[2基] 空冷式 最大TDP350W対応
メモリ	1536GB (64GB×24) DDR5-5600
ストレージ(標準)	3.84TB U.2 NVMe Read 最大12000MB Write 最大6800MB/Sec 1DWPD 高耐久SSD
グラフィック(処理)	[8GPU] NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition 96GB GDDR7 ECC (DisplayPort×4) PCI-E5.0×16
電源	[4PSU] 3000W 80 PLUS Platinum認証 冗長化電源(3+1) 1200 Watts (100V AC input) 3000W (200V AC input) 3200W (240V AC input)
保証	3年間センドバック方式ハードウェア保証

HPC AI Server AISV-X6740Px2MS3Q4TE1S

NVIDIA H200 NVL 8基搭載
Xeon6 Processors AI Server



OS	Ubuntu 24.04 LTS インストール代行
外形寸法	約438.5mm (W) × 175mm (H) × 800 (D)mm 突起部は除く
プロセッサー	[2CPU] Xeon6 6740P 48C/96T 2.1 GHz(最大3.8 GHz) 336MB DDR5(6400MHz) TDP=350 W
プロセッサー・ファン	[2基] 空冷式 最大TDP350W対応
メモリ	2048GB (64GB×32) DDR5-5600
ストレージ(標準)	3.84TB U.2 NVMe Read 最大12000MB Write 最大6800MB/Sec 1DWPD 高耐久SSD
グラフィック(処理)	[8GPU] NVIDIA H200 NVL 141GB
電源	[4PSU] 3000W 80 PLUS Platinum認証 冗長化電源(3+1) 1200 Watts (100V AC input) 3000W (200V AC input) 3200W (240V AC input)
保証	3年間センドバック方式ハードウェア保証

HPC AI Server AISV-EP9455x2MS3Q4TU4U2

NVIDIA H200 NVL 8基搭載
第5世代AMD EPYC AI Server



OS	Ubuntu 24.04 LTS インストール代行
外形寸法	約438.5mm (W) × 175mm (H) × 800 (D)mm 突起部は除く
プロセッサー	[2CPU] AMD EPYC™ 9455 48C/96T 3.15 GHz (最大 4.4 GHz) 256 MB DDR5-6000 TDP=300W
プロセッサー・ファン	[標準] システム内部冷却用FAN 合計10基 8080 Hot-swap System fans
メモリ	1536GB (64GB×24) DDR5-5600
ストレージ(標準)	3.84TB U.2 NVMe Read 最大12000MB Write 最大6000MB/Sec MTBF=200万時間 高耐久SSD
グラフィック(処理)	[8GPU] NVIDIA H200 NVL 141GB
電源	3200W 80 PLUS Platinum認証 冗長化電源(3+1) 1200 Watts (100V AC input) 3000W (200V AC input) 3200W (240V AC input)
保証	3年間センドバック方式ハードウェア保証

S1206



独自のアーキテクチャで設計された
エンタープライズ
EPYC 1Uサーバー



フォームファクター	1U
外形寸法	438.5mm (17.2") W x 43mm (1.7") H x 770mm (30.3") D
プロセッサ	Dual AMD EPYC™ 9004/9005 series processors, up to TDP 210W *Optional EVAC CPU cooler can support up to TDP 360W
メモリ	(24) DDR5 DIMM slots, 12 channels per CPU (1DPC), up to 6400MT/s RDIMM/RDIMM-3DS
ネットワーク	(2) 1000Base-T Ethernet Ports (Intel I350AM2 and NCSI supported)
内蔵ストレージ	(2) 2280 PCIe 3.0 x2 NVMe M.2 ports
拡張スロット	(2) PCIe 5.0 x16 FHHL single wide slots
サーバー管理	(1) 1000Base-T dedicated Server Management Port ASPEED AST2600 with AMI MegaRAC based firmware supporting IPMI 2.0 and DMTF Redfish API Dual BIOS and dual BMC
電源	(1+1) Redundant 1300W CRPS 80 PLUS Platinum
ドライブベイ	(12) Front 2.5" U.2 PCIe 4.0 x4 NVMe

G4101



最大4基のGPU搭載、
12基のU.2ホット
スワップドライブベイ
搭載の4Uサーバー



フォームファクター	4U
外形寸法	438mm (17.2") W x 176mm (6.9") H x 831mm (32.7") D
プロセッサ	Single AMD EPYC™ 9004/9005 series processor, up to TDP 500W, with liquid or air cooling options
メモリ	(12) DDR5 DIMM slots, 12 channels per CPU (1DPC), up to 6400MT/s RDIMM/RDIMM-3DS
ネットワーク	N/A
内蔵ストレージ	(1) 2280/22110 PCIe 3.0 x2 NVMe M.2 port (1) 2280/22110 PCIe 3.0 x4 NVMe M.2 port
拡張スロット	Max (6) PCIe expansion slots: (4) PCIe 5.0 x16 FHFL slots (2) PCIe 4.0 x16 FHFL slots (x8 signal)
サーバー管理	(1) 1000Base-T Dedicated Server Management Port ASPEED AST2600 with AMI MegaRAC based firmware supporting IPMI 2.0 and DMTF Redfish API Single BIOS and dual BMC
電源	(1+1) Redundant 3000W CRPS 80 PLUS Platinum or Titanium
ドライブベイ	(12) Front 2.5" U.2 PCIe 4.0 x4 NVMe

S2206



デュアルAMD EPYC™
9005/9004シリーズ・
プロセッサ搭載可能な
2Uサーバー



フォームファクター	2U
外形寸法	438mm (17.2") W x 87mm (3.4") H x 770mm (30.3") D
プロセッサ	Dual AMD EPYC™ 9004/9005 series processors, up to TDP 400W *CPUs with TDP over 360W only supported under specific conditions. Please contact our representative for details.
メモリ	(24) DDR5 DIMM slots, 12 channels per CPU (1DPC), up to 6400MT/s RDIMM/RDIMM-3DS
ネットワーク	(2) 1000Base-T Ethernet Ports (Intel® I350AM2 and NCSI supported)
内蔵ストレージ	(2) 2280 PCIe 3.0 x2 NVMe M.2 ports
拡張スロット	Max (7) PCIe expansion slots (3) PCIe 5.0 x16 FHFL double wide slots (2) PCIe 5.0 x16 FHFL single wide slots (2) PCIe 5.0 x16 FHFL single wide slots PCIe configurations differ across SKUs
サーバー管理	(1) 1000Base-T Dedicated Server Management Port ASPEED AST2600 with AMI MegaRAC based firmware supporting IPMI 2.0 and DMTF Redfish API Dual BIOS and dual BMC
電源	(1+1) Redundant 2000W or 1600W CRPS 80 PLUS Platinum
ドライブベイ	Max (12) Front 3.5"/2.5" or (24) Front 2.5" storage bays Supports PCIe4.0 x4 U.2 NVMe or SATA/SAS Storage configurations differ across SKUs

CX170-S5062



DC-MHSアーキテクチャで設計された
1Uエンタープライズ
Intelサーバー



フォームファクター	1U
外形寸法	438.5mm (17.2") W x 43mm (1.7") H x 770mm (30.3") D
プロセッサ	Dual Intel® Xeon® 6700E-series, 6500P-series and 6700P-series processors, up to TDP 350W
メモリ	(32) DDR5 DIMM slots, 8 channels per CPU (2DPC), up to 6400MT/s RDIMM (1DPC), 5200MT/s RDIMM (2DPC), and 8000MT/s MRDIMM (1DPC)
ネットワーク	(1) PCIe 5.0 x16 OCP 3.0 slot (NCSI supported)
内蔵ストレージ	(2) 2280/22110 PCIe 5.0 x2 NVMe M.2 ports
拡張スロット	(2) PCIe 5.0 x16 FHHL single wide slots
サーバー管理	(1) 1000Base-T Dedicated Server Management Port ASPEED AST2600 with AMI MegaRAC based firmware supporting IPMI 2.0 and DMTF Redfish API Dual BIOS and dual BMC
電源	(1+1) Redundant 2000W CRPS 80 PLUS Titanium
ドライブベイ	(12) Front 2.5" U.2 PCIe 5.0 x4 NVMe (2) Rear E1.5 9.5mm PCIe 5.0 x4 NVMe

CX270-S5062



デュアルIntel® Xeon®
6500/6700
シリーズプロセッサを搭載!
最大24個のU.2 NVMe
ドライブベイ



フォームファクター	2U
外形寸法	438mm (17.2") W x 87mm (3.4") H x 770mm (30.3") D
プロセッサ	Dual Intel® Xeon® 6700E-series, 6500P-series and 6700P-series processors, up to TDP 350W
メモリ	(32) DDR5 DIMM slots, 8 channels per CPU (2DPC), up to 6400MT/s RDIMM (1DPC), 5200MT/s RDIMM (2DPC), and 8000MT/s MRDIMM (1DPC)
ネットワーク	(1) PCIe 5.0 x16 OCP 3.0 slot (NCSI supported)
内蔵ストレージ	(2) 2280/22110 PCIe 5.0 x2 NVMe M.2 ports
拡張スロット	Max (6) PCIe expansion slots: (2) PCIe 5.0 x16 FHFL double-width slots, supporting up to 600W PCIe cards (2) PCIe 5.0 x16 FHFL single wide slots (2) PCIe 5.0 x16 FHHL single wide slots PCIe configurations and supported TDP of PCIe cards differ across SKUs
サーバー管理	(1) 1000Base-T Dedicated Server Management Port ASPEED AST2600 with AMI MegaRAC based firmware supporting IPMI 2.0 and DMTF Redfish API Dual BIOS and dual BMC
電源	(1+1) Redundant 2700W/3200W CRPS 80 PLUS Titanium
ドライブベイ	(8) or (24) Front 2.5" U.2 PCIe 5.0 x4 NVMe (2) Rear E1.5 9.5mm PCIe 5.0 x4 NVMe

G4201



高性能GPUカード向けに最適化された
最大8つのダブルワイドPCIe 5.0 x16
スロットと、シングルワイドの
PCIe 5.0 x16拡張スロットを搭載!



フォームファクター	4U
外形寸法	438mm (17.2") W x 176mm (6.9") H x 897mm (35.3") D
プロセッサ	Dual Intel® Xeon® 4th/5th Generation Scalable Processors, up to TDP 350W
メモリ	(32) DDR5 DIMM slots, 8 channels per CPU (2DPC), up to 5600MT/s RDIMM (1DPC), 4400MT/s RDIMM (2DPC)
ネットワーク	(1) 1000Base-T Ethernet port
内蔵ストレージ	(2) 2280/22110 PCIe 3.0 x2 NVMe M.2 ports
拡張スロット	G4201RAS10U2-P4-Pt (8) PCIe 4.0 x16 FHFL slots, supporting max 400W PCIe cards (1) PCIe 4.0 x16 FHFL slot (1) PCIe 4.0 x8 FHFL slot G4201RAS8U4-P5-Ti (8) PCIe 5.0 x16 FHFL slots, supporting max 400W PCIe cards (1) PCIe 5.0 x16 FHFL slot G4201RAS10U2-HE (8) PCIe 5.0 x16 FHFL slots, supporting max 600W PCIe cards (1) PCIe 5.0 x16 FHFL slot (1) PCIe 4.0 x8 FHFL slot
サーバー管理	(1) 1000Base-T Dedicated Server Management port ASPEED AST2600 with IPMI 2.0 & DMTF Redfish support Dual BIOS and dual BMC
電源	(3+1) Redundant 2000W/2700W CRPS 80 PLUS Platinum/Titanium (12) Front 3.5"/2.5" support: G4201RAS10U2-P4-Pt/G4201RAS10U2-HE
ドライブベイ	(2) U.2 PCIe 4.0 x4 NVMe + (10) SATA G4201RAS8U4-P5-Ti (4) U.2 PCIe 4.0 x4 NVMe + (8) SATA

超小型 AI スーパーコンピューター「EdgeXpert」

世界に衝撃を与えた小型スパコン



圧倒的な
性能 × 手軽な
小型筐体



MSI EdgeXpert は、約 30cm に、NVIDIA「GB10 スーパー・チップ」を搭載したエッジ AI デバイスです。省スペース設計でありながら、大規模サーバー級の AI 処理を現場で高速に実行できます。GB10 スーパー・チップは、高効率な AI 推論や画像解析に最適化された最新プロセッサで、リアルタイム処理が求められるロボティクスや映像 AI に強みを発揮します。

- アーキテクチャ: NVIDIA Grace Blackwell
- GPU: NVIDIA Blackwell アーキテクチャ
- CPU: 20 コア Arm (10 Cortex-X925 + 10 Cortex-A725)
- CUDA コア: NVIDIA Blackwell
- Tensor コア: 第 5 世代
- RT コア: 第 4 世代
- Tensor パフォーマンス: 1000 AI TOPS
- システムメモリ: 128GB LPDDR5x
- 統合システムメモリ
- メモリ帯域幅: 273GB/s
- ストレージ: 4TB NVMe M.2 (選択可)
- USB: 4 × USB Type-C
- 1 年保証標準付属

科学技術計算向け HPC

Xeon SP	製品イメージ				
	製品名	CERVO Grasta Type-ALES5S-Platinum	CERVO Grasta Type-ALES5S-Gold	CERVO Grasta Type-ALES5S-Silver	HPC Grasta Type-MES5SA-Silver
	OS	Windows 11 Pro/Server2025 Std 各種Linux	Windows 11 Pro/Server2025 Std 各種Linux	Windows 11 Pro/Server2025 Std 各種Linux	Windows 11 Pro/Server2025 Std 各種Linux
	CPU	第4/5世代Xeon Platinum 最大64コア×2	第4/5世代Xeon GOLD 最大32コア×2	第4/5世代Xeon Silver 最大24コア×2	第4/5世代Xeon Platinum 最大64コア×2
	CPU搭載数	2CPU	2CPU	2CPU	2CPU
	CPUクーラー	空冷	空冷	空冷	空冷
	メモリ	64~2048GB(16スロット16ch)	64~2048GB(16スロット16ch)	64~2048GB(16スロット16ch)	64~2048GB(16スロット16ch)
	GPU	NVIDIA GPU各種	NVIDIA GPU各種	NVIDIA GPU各種	NVIDIA GPU各種
	GPU搭載可能数	2GPU	2GPU	2GPU	2GPU
	ストレージ	480GB-7.68TB(SSD)/ 4TB-26TB(HDD)	480GB-7.68TB(SSD)/ 4TB-26TB(HDD)	480GB-7.68TB(SSD)/ 4TB-26TB(HDD)	480GB-7.68TB(SSD)/ 4TB-26TB(HDD)
	電源	1,200W/100V 1,500W/200V	1,200W/100V 1,500W/200V	1,200W/100V 1,500W/200V	1,200W/100V 2,000W/200V
	筐体	タワー型/ラックマウント(4U)両対応	タワー型/ラックマウント(4U)両対応	タワー型/ラックマウント(4U)両対応	タワー型/ラックマウント(4U)両対応
	サイズ	約(W)175×(D)630×(H)435 mm	約(W)175×(D)630×(H)435 mm	約(W)175×(D)630×(H)435 mm	約(W)176×(D)650×(H)427 mm
保証	3年間センドバック方式ハードウェア保証	3年間センドバック方式ハードウェア保証	3年間センドバック方式ハードウェア保証	3年間センドバック方式ハードウェア保証	

Xeon W	製品イメージ				
	製品名	CERVO Grasta Type-ALIS34WC-W9	CERVO Grasta Type-ALIS35WC-W7	CERVO Grasta Type-ALIS35WC-W5	CERVO Grasta Type-ALIS25WC-W3
	OS	Windows 11 Pro/for Workstation 各種Linux	Windows 11 Pro/for Workstation 各種Linux	Windows 11 Pro/for Workstation 各種Linux	Windows 11 Pro/for Workstation 各種Linux
	CPU	Xeon w9-3475X 36コア	Xeon w7-3400/3500 最大28コア	Xeon w5-3400/3500 最大20コア	Xeon w3-2400/2500 最大10コア
	CPU搭載数	1CPU	1CPU	1CPU	1CPU
	CPUクーラー	水冷/空冷	水冷/空冷	水冷/空冷	空冷
	メモリ	64~2048GB(16スロット8ch)	64~2048GB(16スロット8ch)	64~2048GB(16スロット8ch)	64~1024GB(8スロット4ch)
	GPU	NVIDIA GPU各種	NVIDIA GPU各種	NVIDIA GPU各種	NVIDIA GPU各種
	GPU搭載可能数	2GPU	2GPU	2GPU	2GPU
	ストレージ	480GB-7.68TB(SSD)/ 4TB-26TB(HDD)	480GB-7.68TB(SSD)/ 4TB-26TB(HDD)	480GB-7.68TB(SSD)/ 4TB-26TB(HDD)	480GB-7.68TB(SSD)/ 4TB-26TB(HDD)
	電源	1,200W/100V 1,500W/200V	1,200W/100V 1,500W/200V	1,200W/100V 1,500W/200V	1,200W/100V 1,500W/200V
	筐体	タワー型/ラックマウント(4U)両対応	タワー型/ラックマウント(4U)両対応	タワー型/ラックマウント(4U)両対応	タワー型/ラックマウント(4U)両対応
	サイズ	約(W)175×(D)630×(H)435 mm	約(W)175×(D)630×(H)435 mm	約(W)175×(D)630×(H)435 mm	約(W)175×(D)500×(H)435 mm
保証	3年間センドバック方式ハードウェア保証	3年間センドバック方式ハードウェア保証	3年間センドバック方式ハードウェア保証	3年間センドバック方式ハードウェア保証	

GPU Server/科学技術計算向け HPC(AMD)

GPU Server	製品イメージ				
	製品名	CERVO Grasta Type-ALES5S-BWx2	CERVO Grasta Type-ALIS25WC-BWx2	HPC Grasta Type-MIS5S-BWx1	CERVO Grasta Type-ALIS25WC-BWx1
	OS	Windows 11 Pro/Server2025 Std 各種Linux	Windows 11 Pro/for Workstation 各種Linux	Windows 11 Pro/Server2025 Std 各種Linux	Windows 11 Pro/for Workstation 各種Linux
	CPU	第4/5世代Xeon Scalable 最大64コア×2	Xeon w5-2400/2500 最大26コア	第4/5世代Xeon Silver 最大64コア	Xeon w3/5/7-2400/2500 最大26コア
	CPU搭載数	2CPU	1CPU	1CPU	1CPU
	CPUクーラー	空冷	水冷	空冷	水冷
	メモリ	64~2048GB(16スロット16ch)	64~1024GB(8スロット8ch)	64~1024GB(8スロット8ch)	64~1024GB(8スロット8ch)
	GPU	NVIDIA GPU各種×2	NVIDIA GPU各種×2	NVIDIA GPU各種	NVIDIA GPU各種
	GPU搭載可能数	2GPU	2GPU	2GPU	2GPU
	ストレージ	480GB-7.68TB(SSD)/ 4TB-26TB(HDD)	480GB-7.68TB(SSD)/ 4TB-26TB(HDD)	480GB-7.68TB(SSD)/ 4TB-26TB(HDD)	480GB-7.68TB(SSD)/ 4TB-26TB(HDD)
	電源	1,200W/100V 2,000W/200V	1,200W/100V 2,000W/200V	1,200W/100V 2,000W/200V	1,200W/100V 1,500W/200V
	筐体	タワー型/ラックマウント(4U)両対応	タワー型/ラックマウント(4U)両対応	タワー型/ラックマウント(4U)両対応	タワー型/ラックマウント(4U)両対応
	サイズ	約(W)175×(D)630×(H)435 mm	約(W)175×(D)500×(H)435 mm	約(W)176×(D)650×(H)438 mm	約(W)175×(D)500×(H)435 mm
保証	3年間センドバック方式ハードウェア保証	3年間センドバック方式ハードウェア保証	3年間センドバック方式ハードウェア保証	3年間センドバック方式ハードウェア保証	

Threadripper	製品イメージ				
	製品名	CERVO Ryzen Type-RT9PRO-9995WX	CERVO Ryzen Type-RT9PRO-9975WX	CERVO Ryzen Type-RT9-9980X	CERVO Ryzen Type-RT9-9960X
	OS	Windows 11 Pro/for Workstation 各種Linux	Windows 11 Pro/for Workstation 各種Linux	Windows 11 Pro/for Workstation 各種Linux	Windows 11 Pro/for Workstation 各種Linux
	CPU	Ryzen Threadripper PRO 9995WX 96コア	Ryzen Threadripper PRO 9975WX 32コア	Ryzen Threadripper 9980X 64コア	Ryzen Threadripper 9960X 24コア
	CPU搭載数	1CPU	1CPU	1CPU	1CPU
	CPUクーラー	水冷	水冷	水冷	水冷
	メモリ	128~768GB(8スロット8ch)	128~768GB(8スロット8ch)	64~256GB(4スロット4ch)	64~256GB(4スロット4ch)
	GPU	NVIDIA GPU各種	NVIDIA GPU各種	NVIDIA GPU各種	NVIDIA GPU各種
	GPU搭載可能数	2GPU	2GPU	2GPU	2GPU
	ストレージ	1TB-4TB(SSD)/4TB-24TB(HDD)	1TB-4TB(SSD)/4TB-24TB(HDD)	1TB-8TB(SSD)/4TB-24TB(HDD)	1TB-8TB(SSD)/4TB-24TB(HDD)
	電源	1,200W/100V 2,000W/200V	1,200W/100V 2,000W/200V	1,200W/100V 2,000W/200V	1,200W/100V 2,000W/200V
	筐体	タワー型/ラックマウント(4U)両対応	タワー型/ラックマウント(4U)両対応	タワー型	タワー型
	サイズ	約(W)175×(D)630×(H)435 mm	約(W)175×(D)630×(H)435 mm	約(W)235×(D)470×(H)495 mm	約(W)235×(D)470×(H)495 mm
保証	3年間センドバック方式ハードウェア保証	3年間センドバック方式ハードウェア保証	3年間センドバック方式ハードウェア保証	3年間センドバック方式ハードウェア保証	

HPC Deep/HPC AI Server/Edge Server

EPYC Xeon	製品イメージ				
	製品名	HPC AI Server Type-MSHP4UEP1S12B	HPC AI Server Type-MSHP4UX2S12B	HPC Deep Type-AS2UX2S4GP	HPC Deep Type-AS4UX2S8GP
	OS	Windows Server 各種Linux	Windows Server 各種Linux	各種Linux	各種Linux
	CPU	第4/5世代EPYC 最大192コア	第5世代Xeon Scalable 最大64コア×2	第5世代Xeon Scalable 最大64コア×2	第5世代Xeon Scalable 最大64コア×2
	CPU搭載数	1CPU	2CPU	2CPU	2CPU
	CPUクーラー	液冷モジュール(最大500W)	パッシブ・プロセッサ・ヒートシンク	パッシブ・プロセッサ・ヒートシンク	パッシブ・プロセッサ・ヒートシンク
	メモリ	64~1536GB(12スロット12ch)	64~4096GB(32スロット16ch)	128~2048GB(16スロット16ch)	256~4096GB(32スロット16ch)
	GPU	NVIDIA GPU各種	NVIDIA GPU各種	NVIDIA GPU各種	NVIDIA GPU各種
	GPU搭載可能数	4GPU	8GPU	4GPU	8GPU
	ストレージ	960GB-15.36TB(SSD)	1.92TB-15.36TB(SSD)/ 4TB-26TB(HDD)	1.92TB-15.36TB(SSD)/ 2TB-24TB(HDD)	1.92TB-15.36TB(SSD)/ 2TB-24TB(HDD)
	電源	2,800W/200V(冗長化1+1)	1,800W/200V(冗長化3+1)	2,600W/200V(冗長化1+1)	3,000W/200V(冗長化2+2)
	筐体	ラックマウント(4U)	ラックマウント(4U)	ラックマウント(2U)	ラックマウント(4U)
	サイズ	約(H)176×(W)438×(D)831 mm	約(H)176×(W)438×(D)897 mm	約(H)89×(W)440×(D)800 mm	約(H)174×(W)440×(D)800 mm
保証	3年間センドバック方式ハードウェア保証	3年間センドバック方式ハードウェア保証	3年間センドバック方式ハードウェア保証	3年間センドバック方式ハードウェア保証	

Xeon	製品イメージ				
	製品名	CERVO-Grasta Type-MGX-H200	CERVO-Grasta Type-MGX-PRO6000	HPC Edge Server Type-AEG1UX1S-R	HPC Edge Server Type-AEG2UX1SF-R
	OS	Windows Server 各種Linux	Windows Server 各種Linux	Windows Server 各種Linux	Windows Server 各種Linux
	CPU	Xeon 6 プロセッサ 最大86コア×2	Xeon 6 プロセッサ 最大86コア×2	第5世代Xeon Scalable 16コア×2	第5世代Xeon Scalable 16コア×2
	CPU搭載数	2CPU	2CPU	2CPU	2CPU
	CPUクーラー	空冷CPUクーラー	空冷CPUクーラー	パッシブ・プロセッサ・ヒートシンク	パッシブ・プロセッサ・ヒートシンク
	メモリ	128~4096GB(32スロット16ch)	128~4096GB(32スロット16ch)	64GB(8スロット8ch)	64GB(8スロット8ch)
	GPU	NVIDIA GPU各種	NVIDIA GPU各種	—	—
	GPU搭載可能数	8GPU	8GPU	—	—
	ストレージ	1.92TB-7.68TB(SSD)	1.92TB-7.68TB(SSD)	960GB(SSD)	960GB(SSD)
	電源	3,000W/200V(冗長化3+1)	3,000W/200V(冗長化3+1)	650W/100V(冗長化1+1)	1,300W/100V(冗長化1+1)
	筐体	ラックマウント(4U)	ラックマウント(4U)	ラックマウント(1U)	ラックマウント(2U)
	サイズ	約(H)175×(W)438×(D)800 mm	約(H)175×(W)438×(D)800 mm	約(H)43×(W)438×(D)430 mm	約(H)87×(W)438×(D)430 mm
保証	3年間センドバック方式ハードウェア保証	3年間センドバック方式ハードウェア保証	3年間センドバック方式ハードウェア保証	3年間センドバック方式ハードウェア保証	

ラックマウントエントリーサーバー・ラックマウントストレージサーバー

HPC
エントリーサーバー




ラックマウント
ストレージサーバー

製品イメージ				
製品名	HPC SERVE Type-MSEN1URY1S	HPC SERVE Type-MSEN1URY1SWC	CERVO SERVE Type-Aカスタマイズ-Bronze	CERVO SERVE Type-Bカスタマイズ-Silver
OS	Windows Server 各種Linux	Windows Server 各種Linux	Windows Server 各種Linux	Windows Server 各種Linux
CPU	Ryzen7000/9000 最大12コア	Ryzen7000/9000 最大16コア	インテル Xeon スケーラブル 最大64コア	インテル Xeon スケーラブル 最大64コア
CPU搭載数	1CPU	1CPU	1CPU	1CPU
CPUクーラー	1U 空冷モジュール(最大105W)	1U水冷モジュール	アクティブ・プロセッサ・ヒートシンク	アクティブ・プロセッサ・ヒートシンク
メモリ	16~192GB(4スロット2ch)	16~192GB(4スロット2ch)	2TB (8スロット8ch)	2TB (8スロット8ch)
GPU	D-Sub15(ASPEED AST2600 BMC) オンボード	D-Sub15(ASPEED AST2600 BMC) オンボード	D-Sub15 (ASPEED AST2600 BMC)オンボード NVIDIA GPU各種	D-Sub15 (ASPEED AST2600 BMC)オンボード NVIDIA GPU各種
GPU搭載可能数	—	—	1GPU	1GPU
ストレージ	SATA3-SSD/ HDD最大4基、M.2NVMeSSD最大2基 480GB-15.36TB(SSD)/ 4TB-26TB(HDD)	SATA3-SSD/ HDD最大4基、M.2NVMeSSD最大2基 480GB-15.36TB(SSD)/ 4TB-26TB(HDD)	SATA3-SSD/ HDD最大8基、M.2NVMeSSD最大2基 480GB-15.36TB(SSD)/ 4TB-26TB(HDD)	SATA3-SSD/ HDD最大8基、M.2NVMeSSD最大2基 480GB-15.36TB(SSD)/ 4TB-26TB(HDD)
電源	600W/100V(冗長化1+1)	600W/100V(冗長化1+1)	850W/100V	850W/100V
筐体	ラックマウント(1U)	ラックマウント(1U)	タワー型/ラックマウント(4U)両対応	タワー型/ラックマウント(4U)両対応
サイズ	約(H)43×(W)438×(D)547 mm	約(H)43×(W)438×(D)660 mm	約(H)435×(W)175×(D)630 mm	約(H)435×(W)175×(D)630 mm
保証	3年間センドバック方式ハードウェア保証	3年間センドバック方式ハードウェア保証	3年間センドバック方式ハードウェア保証	3年間センドバック方式ハードウェア保証

ラックマウント
ストレージサーバー

製品イメージ				
製品名	CERVO SERVE Type-Cカスタマイズ-GOLD	HPC Server Type-MSST1UX2S12B	HPC Server Type-MSST2UX2S12B	HPC Server Type-MSST2UX2S24B
OS	Windows Server 各種Linux	Windows Server 各種Linux	Windows Server 各種Linux	Windows Server 各種Linux
CPU	インテル Xeon スケーラブル 最大64コア	第4/5世代Xeon Scalable 最大64コア×2	第4/5世代Xeon Scalable 最大64コア×2	第4/5世代Xeon Scalable 最大64コア×2
CPU搭載数	1CPU	2CPU	2CPU	2CPU
CPUクーラー	アクティブ・プロセッサ・ヒートシンク	パッシブ・クーリング・モジュール(最大205W)	パッシブ・クーリング・モジュール(最大350W)	パッシブ・クーリング・モジュール(最大350W)
メモリ	2TB (8スロット8ch)	64~4096GB(32スロット8ch×2)	64~4096GB(32スロット8ch×2)	64~4096GB(32スロット8ch×2)
GPU	D-Sub15 (ASPEED AST2600 BMC)オンボード NVIDIA GPU各種	D-Sub15 (ASPEED AST2600 BMC)オンボード NVIDIA GPU各種	D-Sub15 (ASPEED AST2600 BMC)オンボード NVIDIA GPU各種	D-Sub15 (ASPEED AST2600 BMC)オンボード NVIDIA GPU各種
GPU搭載可能数	1GPU	1GPU	2GPU	2GPU
ストレージ	SATA3-SSD/ HDD最大8基、M.2NVMeSSD最大2基 480GB-15.36TB(SSD)/ 4TB-26TB(HDD)	U.2NVMeSSD最大12基、 M.2NVMeSSD最大2基 480GB-15.36TB(SSD)/ 4TB-26TB(HDD)	3.5/2.5U.2SSD最大12基、 M.2NVMeSSD最大2基 480GB-15.36TB(SSD)/ 4TB-26TB(HDD)	2.5U.2SSD最大24基、 2.5SATA3SSD最大4基 480GB-15.36TB(SSD)/ 4TB-26TB(HDD)
電源	850W/100V	1,300W/100V or 200V(冗長化1+1)	1,800W/200V or 1,000V(100V)(冗長化1+1)	1,600W/200V or 1,000V(100V)(冗長化1+1)
筐体	タワー型/ラックマウント(4U)両対応	ラックマウント(1U)	ラックマウント(2U)	ラックマウント(2U)
サイズ	約(H)435×(W)175×(D)630 mm	約(H)43×(W)438×(D)770 mm	約(H)87×(W)438×(D)770 mm	約(H)87×(W)438×(D)770 mm
保証	3年間センドバック方式ハードウェア保証	3年間センドバック方式ハードウェア保証	3年間センドバック方式ハードウェア保証	3年間センドバック方式ハードウェア保証

ラックマウントストレージサーバー・ラックマウントAIサーバー・
ラックマウントヘッドサーバー大容量ストレージサーバーセット・NAS

ラックマウント ストレージサーバー	製品イメージ				
	製品名	HPC Server Type-MSST1UEP2S12B	HPC Server Type-MSST2UEP2S12B	HPC Server Type-MSST2UEP2S24B	HPC AI SERVE MGXシリーズ
	OS	Windows Server 各種Linux	Windows Server 各種Linux	Windows Server 各種Linux	Windows Server 各種Linux
	CPU	第4/5世代EPYC 最大128コア×2	第4/5世代EPYC 最大128コア×2	第4/5世代EPYC 最大128コア×2	第4/5世代EPYC 最大128コア×2
	CPU搭載数	2CPU	2CPU	2CPU	2CPU
	CPUクーラー	パッシブ・クーリング・モジュール(最大210W)	パッシブ・クーリング・モジュール(最大360W)	パッシブ・クーリング・モジュール(最大360W)	空冷モジュール(最大350W)
	メモリ	64~3072GB(24スロット12ch×2)	64~3072GB(24スロット12ch×2)	64~3072GB(24スロット12ch×2)	64~3072GB(24スロット12ch×2)
	GPU	D-Sub15 (ASPEED AST2600 BMC)オンボード NVIDIA GPU各種	D-Sub15 (ASPEED AST2600 BMC)オンボード NVIDIA GPU各種	D-Sub15 (ASPEED AST2600 BMC)オンボード NVIDIA GPU各種	D-Sub15 (ASPEED AST2600 BMC)オンボード NVIDIA GPU各種
	GPU搭載可能数	1GPU	3GPU	1GPU	8GPU
	ストレージ	U.2NVMeSSD最大12基、 M.2NVMeSSD最大2基 480GB-15.36TB(SSD)/ 4TB-26TB(HDD)	3.5/2.5U.2SSD最大12基、 M.2NVMeSSD最大2基 480GB-15.36TB(SSD)/ 4TB-26TB(HDD)	2.5U.2SSD最大16基、 2.5SATA3SSD最大8基 480GB-15.36TB(SSD)/ 4TB-26TB(HDD)	2.5U.2SSD最大8基 480GB-15.36TB(SSD)/ 4TB-26TB(HDD)
	電源	1,300W/100Vor200V(冗長化1+1)	1,800W/200Vor1,000V(100V)(冗長化1+1)	1,600W/200V or 1,000V(100V)(冗長化1+1)	3,200W/200V(冗長化3+1)
	筐体	ラックマウント(1U)	ラックマウント(2U)	ラックマウント(2U)	ラックマウント(4U)
	サイズ	約(H)43×(W)438×(D)770 mm	約(H)87×(W)438×(D)770 mm	約(H)87×(W)438×(D)770 mm	約(H)174×(W)440×(D)800 mm
保証	3年間センドバック方式ハードウェア保証	3年間センドバック方式ハードウェア保証	3年間センドバック方式ハードウェア保証	3年間センドバック方式ハードウェア保証	

大容量 ストレージサーバー セット	製品イメージ				
	製品名	HPC SERVE Type-SM2U2S12B-JB1080 (2U ヘッドサーバーと4U JBOD ストレージユニット)		Dmaster-NAS Type-QTSh3087XURPシリーズ	D-Master NAS Type-AS7112RDXシリーズ
	本体	ヘッド・サーバー	1080TB JBODストレージ・ユニット	4UラックマウントNAS	2UラックマウントNAS
	OS	非搭載・オプション(Windows/Linux)	非搭載・オプション(Windows/Linux)	Qnap QuTS Hero	ASUSTOR Data Master (ADM)
	CPU	Xeon Scalableプロセッサ	—	Xeon E-2378 8コア	Xeon E-2224 4コア
	CPU搭載数	2CPU	—	1CPU	1CPU
	メモリ	64~4096GB(32スロット16ch)	—	8GB~128GB	8GB~128GB
	GPU	NVIDIA GPU各種	—	—	—
	GPU搭載可能数	1GPU	—	—	—
	ストレージ	[RAID1 480GB] 480GB2 高耐久 SSD(SATA3 6Gb/s)	1080TB JBODストレージ (SAS 18TB HDD ×60)	3.5SATA最大24基、 2.5SATA最大6基 480GB-15.36TB(SSD)/ 4TB-26TB(HDD)	2.5/3.5SATA最大12基、 キャッシュ用M.2NVMeSSD2基 480GB-15.36TB(SSD)/ 4TB-26TB(HDD)
	電源	[冗長化] 770W(1+1)	1,800W/200V(冗長化1+1)	800W(冗長化1+1)	550W(冗長化1+1)
	筐体	ラックマウント(2U)	ラックマウント(4U)	ラックマウント(4U)	ラックマウント(2U)
	サイズ	約(H)87×(W)438×(D)770 mm	約(H)175×(W)438×(D)800 mm	約(H)176×(W)441×(D)630 mm	約(H)88×(W)439×(D)535 mm
保証	3年間センドバック方式ハードウェア保証		3年間センドバック方式ハードウェア保証	3年間センドバック方式ハードウェア保証	

OS やソフトウェアのインストール代行から、深層学習・ Docker などの環境も構築

アプライドではHPC製品(ハイ・パフォーマンス・コンピューティング)の製造だけでなく、科学技術計算用ソフトウェアのインストール代行も承っております。弊社製のHPC製品であれば、納品後すぐにお使いいただけるように、工場で製造後に専門スタッフがソフトウェアのインストールを行ってから出荷いたします。また、弊社 HPC 製品だけではなく、他社製のHPC製品へのインストール代行も承っております。OSから科学技術計算用ソフトウェア、ディープラーニング設定、Docker環境構築など、お気軽にお問い合わせください。

ソフトウェア・インストール代行および環境構築一覧

インストール作業名称

・Linux ディープラーニング構築 (NV HPC, NVIDIA Docker, venv環境構築)	・Lammps (GPU動作) インストール代行
・Linux ディープラーニング構築 (NV HPC, NVIDIA Docker)	・Quantum ESPRESSO (CPU)
・Windows ディープラーニング構築(Anaconda-GPU設定あり)	・インストール代行
・FPGA インストール代行	・CPUのみの使用GCCコンパイル
・COGNEX インストール代行	・Quantum ESPRESSO (CPU)nvhpc使用
・OpenForm インストール代行	・インストール代行
・インテル コンパイラ(OneAPI 設定)	・Quantum ESPRESSO (GPU)nvhpc使用
・DualBoot インストール代行	・インストール代行
・WindowsリカバリーUSB作成	・VASPインストール代行
・UPS設定(EatonとOmronとAPC製)	・NV HPC インストール代行
・UPS設定(ネットワーク)(EatonとOmronとAPC製)	・Relion インストール代行
・Anaconda設定(Anacondaのみ)	・Samba インストール代行
・R	・OpenMP インストール代行
・R インストール代行	・MATLABインストール※
・Gromacs (GPU動作) インストール代行	

Linux 関係

・Ubuntuインストール代行 (AlmaLinux RockyLinux含む)
・NFS設定
・NIS設定
・UPS設定
・Sambaインストール
・GPU取付/交換(ドライバ・CUDAインストール)
・ストレージ増設(マウント設定まで含む)

Windows 関係

・リモートデスクトップサービス(RDS)構築
・Active Directory(ドメインコントローラ)構築
・ファイルサーバー構築
・SQLサーバー構築

その他各種ご希望のソフトウェアインストール代行
(Gromacs、Amber、Gaussian 等)
詳細はお問い合わせください。

インストール代行 ローカル LLM / RAG 構築

LLM / RAG
スタートアップキットの提供
研究環境を支援

インストール・設定ソリューションサービス 対象ツール

 Dify 実運用可能な AI Agent を簡単に構築できる開発ツール	 Llama Meta 製のオープンな大規模言語モデル
 Ollama ローカルで LLM を簡単に実行・管理できるツール	 Gemma Google 製の軽量・高性能な言語モデル
 Xinference 複数の AI モデルを効率的に統合・管理する基盤	 gpt-oss-20B OpenAI 公開の高性能・軽量 LLM

インストール代行 ローカル LLM / RAG 構築サービス

サービス内容 OS : Ubuntu / Windows GPU : NVIDIA RTX / GeForce 開発・実行環境 : Dify / Ollama / Xinference 対応モデル : Llama / Gemma / gpt-oss-20B	費用 198,000円~(税別)
特長 社内データを守るオンプレミス環境 構築済みで導入後すぐ利用可能 導入後 1 か月サポート付き	サポート (有償) 講習・トラブル対応 バージョンアップ 個別環境の構築支援

HPC Remote Desktop Services

HPC リモートデスクトップサービスとは

HPCサーバーの計算資源を複数ユーザーで共有し、クライアントPCから安全に遠隔操作できるサービスです。研究・開発現場の待ち時間と運用負担を大幅に削減します。



1台の計算機が、複数人で遠隔操作できるようになる！
ただのリモート設定ではない！HPC の台数を増やさずに
研究効率を上げられるおススメ提案！

費用について 作業費 (目安):15万円~30万円

設定するクライアント PC の台数や、様々な要因によって料金が異なります。
今の環境を教えてくださいすぐにお見積り可能ですので、まずはご相談下さい。

構築作業の概要 ※内容が環境によって異なるため一例になります

- ドメインコントローラ (DC) 用サーバーに対してドメインサービス構築
- DC 用サーバー内に RDS サービス構築 (RDS ライセンスサーバー等)
- DC 用サーバーに RDS CAL を登録
- 各計算機に対して RDS サーバー (セッションホスト) 構築
- ドメインサーバーにユーザー登録実施
- 各クライアント PC から各計算機にリモート接続できるか確認

WEBサイトで
簡単見積り!

アプライド HPC&AI

商品をじっくり選んで「見積り依頼」もしくは「ご注文」、「仕様書ダウンロード」が簡単にできます!

たった**3分**で! 製品仕様と概算見積りまで完了!

step
1

様々なタイプから商品を選択

BTO PC、ワークステーション、HPCサーバーなど様々なタイプのコンピューターからお客様のビジネスに合わせた商品を選択。



step
2

仕様カスタマイズ

カスタマイズ見積りのボタンを押していただき、自由にカスタマイズください。お見積り・ご注文へ進むボタンで次に進んでください。



step
3

お見積り依頼・仕様ダウンロード

選択頂いたカスタマイズの内容にて仕様書をダウンロード頂けます。また、併せてWEBサイトよりお見積り依頼いただけます。



各種モデル様々なカスタマイズに対応致します!

グラフィックボード



3Dグラフィックの描画処理性能で選ぶ (GeForceシリーズ)



AI、HPCワークフローに最適化 (RTX Adaシリーズ)

基本システム (OS)

CPU	メモリ	ストレージ
ビジネスソフト(Office)	電源ユニット	I/O拡張ボード
キーボード/マウス		

提供オペレーティングシステム (OS)

アプライドのBTO PCはお客様のご用途に合わせて、ビジネス向けの様々なOSに対応しております。



HPC専用サイト <https://bto.applied.ne.jp/>
HPC / SERVER / AI SERVER

アプライド HPC 検索



ご相談無料! アプライドHPCご購入前相談窓口



DeepLearningモデルをはじめとしたHPC製品について、お電話または簡単な専用フォームに入力するだけでご相談いただけます。商品詳細、お見積りや導入などご不明な点がございましたらどうぞご相談ください。弊社技術スタッフが徹底サポートいたします。



HPCご購入前相談窓口
092-481-8050
受付時間: 10:00-17:00



HPCご購入前
相談フォーム



*APPLIED
GROUP

福岡に HPC 開発部門生産工場を設置

MSA-QS-5054 MS CM024
MSA-ES-1999
ISO9001 ISO14001認定工場

msi x APPLIED
GROUP

Micro-Star International Co., Ltd.と提携し、日本市場におけるサーバー製品のプレミアムディストリビューター契約を締結

PREferred PARTNER
NVIDIA

当社はソリューションプロバイダーとして、テクノロジーの専門知識とサービスを組み合わせ、お客様の求めるビジネスおよび技術の要件を満たす NVIDIA GPU コンピューティングソリューションを設計、再販、導入までのご提供を開始いたします。

「AIの日常化に挑戦する会社」

アプライド株式会社 法人営業部

アプライド HPC&AIサイト

<https://bto.applied.ne.jp/>

【法人様 お問い合わせ窓口】

○ 関西営業所 大阪市淀川区西中島2-14-6 新大阪第2ビル5階 TEL:06-6838-4123	FAX:06-6838-4122	○ 東海営業所 名古屋市中区上本町3-25-28 第7階(いむら)ビル5階 TEL:052-325-2782	FAX:052-325-2792
○ 関東営業所 東京都千代田区神田小川町1-11 小川町クロス4階 TEL:03-5280-9255	FAX:03-5280-9254	○ 九州営業所 福岡市博多区上牟田1-6-23 TEL:092-481-7812	FAX:092-481-7822

【大学官公庁様 お問い合わせ窓口】

○ SI 東京営業所 東京都千代田区神田小川町1-11 小川町クロス4階 TEL:03-5280-9250	FAX:03-5280-9253	○ SI 仙台営業所 仙台市宮城野区新田東3-3-5 TEL:022-782-2737	FAX:022-782-2738
○ SI 筑波営業所 茨城県つくば市福荷前34-13 TEL:029-860-7808	FAX:029-860-7809	○ SI 名古屋営業所 名古屋市中区上本町3-25-28 第7階(いむら)ビル5階 TEL:052-325-2783	FAX:052-325-2791
○ SI 北陸営業所 石川県野々市市二日市3-86 TEL:076-294-1451	FAX:076-294-1452	○ SI 大阪営業所 大阪市淀川区西中島2-14-6 新大阪第2ビル5階 TEL:06-6838-4123	FAX:06-6838-4122
○ SI 京都営業所 京都市右京区西院西瀬崎町7 TEL:075-325-1025	FAX:075-325-1026	○ SI 岡山営業所 岡山市北区鹿田本町7-24 TEL:086-235-2703	FAX:086-235-2705
○ SI 広島営業所 広島市西区楠木町1-10-1 TEL:082-235-3536	FAX:082-235-3537	○ SI 福岡営業所 福岡市博多区上牟田1-6-23 TEL:092-481-7802	FAX:092-481-7651
○ SI 北九州営業所 北九州小倉北区香春口1-7-4 TEL:093-932-6507	FAX:093-932-6508	○ SI 熊本営業所 熊本市東区西原3-1-7 TEL:096-384-5255	FAX:096-384-5257
○ SI 鹿児島営業所 鹿児島市上之園町33-2 TEL:099-214-3918	FAX:099-214-3919		